Cicor Group

Firmenbeschreibung Cicor Technologies

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit 1 841 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und 3D-MID-Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunststoff-Spritzguss-Dienstleistungen.

Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden.

Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN).

Kernkompetenzen

Herstellung von Substraten

Cicor Advanced Microelectronics & Substrates beschäftigt sich mit der Herstellung von hochzuverlässigen Substraten auf Basis von PCB-Technologie, Dünnfilmtechnik und Dickschichttechnik. Im Bereich der PCB erstrecken sich die verfügbaren Technologien über diese Bereiche: - Flexible, starre und starr-flexible PCBs - High Density Interconnects (HDIs) - Multi-Chip-Module (MCM) - Starre Leiterplatten mit 1–32 Lagen - Mehrlagige Schaltungen aus Polyimid, Polyimid-Glas, LCP, FR4, FR4 High Tg, HF-Substrat - Panel- und Reel-to-Reel-Fertigung - Leiterstrukturen bis zu 25/25 µm - Laser-Microvias bis zu 30 µm Durchmesser - Mechanische Vias bis zu 75 µm Durchmesser - Gefüllte Blind Vias -Stacked/staggered Microvias bis 6-n-6 - Impedanzkontrollierte Leiterplatten +/-5% - Dünne Basismaterialien bis zu 12,5 µm - Leiterplattendicken bis 4,0 mm - Laseraussparungen (Kavitäten) - Materialien für Temperaturmanagement - Umfangreiches Portfolio von Endoberflächen: - - Immersion Sn - - Immersion Ag - - ENIG - - ENEPIG - - OSP - - Galvanisch Ni/Au - - HASL Im Bereich der Dünnschichttechnik werden folgende Technologien angeboten: - Dünnschichtsubstrate auf Polymer, Keramik, Stahl, Glas, Ferrit etc. - Keramik-/Polyimid-Mehrlagenschaltungen - Flexible Mehrlagenschaltungen mit höchster Auflösung (10 µm) - Integrierte Widerstände und Koppler - Dick-Kupfer-Dünnschichtschaltungen für Leistungsanwendungen - Hochpräzise, hochohmige

Widerstände/Widerstandsnetzwerke - Kupfer-Filled-Via - MEMS Im Bereich der Dickschichttechnik werden folgende Technologien angeboten: - Dickschichtsubstrate auf Al2O3, AlN, Ferrit etc. - Verschiedene Leitbahnmaterialien (bondfähig, lötfähig) - Gedruckte Widerstände (getrimmt aktiv/passiv) - Geätzte Strukturen (bis 40 µm) - DC-/HF-Mehrlagenschaltungen

Microassembly und Packaging, Test

Cicor Advanced Microelectronics & Substrates bietet zusätzlich auch Dienstleistungen im Bereich der Mikromontage, des Packing und des Testens von Mikroelectronikschaltungen. Im Bereich der Bestückung erstrecken sich diese Dienstleistungen über folgende Bereiche: - Mikromontage auf flexiblen und starren Substraten (Keramik, Stahl, Ferrit, Glas, Polymer, Leiterplatten etc.) - Bauelemente- / Baugruppenbestückung - Die-Attach, COB, Flip-Chip, Nacktchips, MMICs, SMD (min. 01005), (µ)BGA - Al- und Au-Draht-/Bändchenbonden - Automatisches Ball-Wedge-/Wedge-Wedge-Bonden - Flussmittelfreies Löten unter Vakuum, Kleben Typischerweise wird die Montage auf folgenden Basismaterialien durchgeführt:: -- Dünnschichtsubstrate für Mikrowellenanwendungen, opto-elektronische Komponenten und thermisches Management -- Dickschichtsubstrate, auch für Leistungsmodule -- Spezifische HF- und Mikrowellen-PCBs -- Standard FR4, starre, starr-flexible und flexible PCB, Multilayer -- Flexible Substrate (Folien, Polyimide, LCPs, Silicone) -- Kombinationen verschiedenartiger Verdrahtungsträger in einer Baugruppe -- Montage von Verdrahtungsträgern auf Trägermaterialien, auf Heatsinks und in Modulgehäusen Im Bereich des Testens und der Qualifizierung bieten wir unter anderem folgende Dienstleistungen an: - Qualifizierung von Bauelementen und Baugruppen gemäß MIL- und ESA-Standards - Screening & Tests: -- Burn-in -- Temperatur- / Feuchtelagerung -- Schnelle Temperaturwechsel -- Vibration -- Beschleunigung -- Prüfung der Grundgrößen U, I, R, C, f, t -- HF-Messtechnik bis 50 GHz -- Weitere elektrische, optische und thermische Tests

Komplette "Electronic Solutioins"

Die Electronics Solutions (ES) Division von Cicor ist ein international aufgestellter Elektronikdienstleister mit einem breiten Fertigungsspektrum in der Leiterplattenbestückung, in Systembau und Box Building, im Schaltschrankbau, in der Kabelkonfektion und im Bereich von Werkzeugbau und Kunststoff-Spritzguss. Wir bieten Outsourcing-Lösungen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Baugruppen sowie kompletter Geräte und Systeme. Als global tätiges Unternehmen mit Produktionsstandorten in der Schweiz, Rumänien und Asien (Singapur, Vietnam, Indonesien, China) nutzen wir unsere Synergien und bieten Lösungen, die auf langjährigem Know-how basieren. Wir bieten hierbei unter anderem Dienstleistungen und Produktion in den folgenden Breichen an: - Produktion - R&D Services - Test Engineering - Industrialisierung - Kunststoffspritzguss - 3D-MID-Technologie

Wertschöpfungskette:

- Produktion
- Zulieferer Komponenten
- Teilsysteme

Technologie:

- AVT/ Packaging
- Foundry
- Komponenten
- Teilsysteme

- Materialbearbeitung
- Mikroelektronik/ Embedded Systems

Branche:

- Elektronik/ Elektrotechnik
- Informationstechnik und Telekommunikation
- Luft- und Raumfahrt
- Medizintechnik
- Sicherheitstechnik

Hauptgeschäftssitz

Sedanstrasse 14
89077 Ulm
info@cicor.com
www.cicor.com

Ansprechpartner

Name: Dr.-Ing. Alexander Kaiser
Abteilung: Technology / Development
Tel.: +49 (0) 731 / 98588 425
alexander.kaiser@cicor.com

Weitere Informationen

Niederlassungen (Orte): Schweiz, Deutschland, Rumänien, China, Vietnam, Singapur, Indonesien
Mitarbeiterzahl: 1841